

報道関係者各位

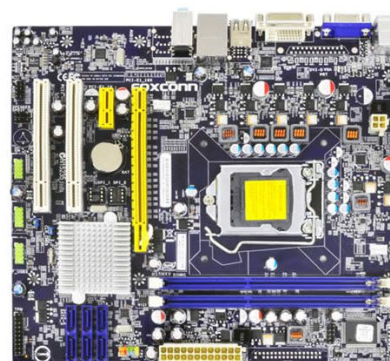
2010 年 6 月 25 日

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

グラフィックス統合型 CPU をサポートする Intel H55 チップセット搭載 Intel Core i3/i5/i7、Pentium G 対応、DDR3 デュアルチャンネル対応 Micro ATX マザーボード H55MXV-LE

FOXCONN 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、グラフィックス統合型 CPU をサポートする Intel H55 チップセット搭載 Micro ATX マザーボード H55MXV-LE を 2010 年 6 月 26 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

H55MXV-LE は、グラフィックス統合型 CPU をサポートする H55 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Pentium G に対応します。グラフィックス統合型 CPU を使用することで、オンボードのグラフィックスを使用することができます。



CPU 周りにアルミ固体コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、さらに高い耐久性を実現しました。

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333/1066/800MHz に対応します。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェースの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。接続するケーブルごとに色分けされているので、迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

対応 CPU は、LGA1156、Intel Core i3/i5/i7、Pentium G プロセッサです。対応メモリは、メモリスロット×2、DDR3、クロック 1333/1066/800MHz、最大 8GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット×1(x16 動作)、PCI Express x1 スロット×1、PCI スロット×2 です。

ストレージ接続は、SATA 3Gb/s×6、USB 2.0/1.1×10(リアパネル I/O ポート×4、内部 I/O コネクタ×6) [※1]。リアパネル I/O ポートは、PS/2 キーボード×1、PS/2 マウス×1、USB 2.0/1.1×4、DVI-D×1、D-Sub×1、ギガビット LAN×1、オーディオ 3 ジャック×1。

同梱ケーブルは、SATA ケーブル×2、SATA 電源コネクタ→ペリフェラル電源変換ケーブル×2 が付属[※2]します。フォームファクタは Micro ATX、サイズは 244mm×229mm です。

[※1]最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。

[※2]付属品は予告なく変更される可能性があります。

【H55MXV-LE 製品特徴】

・グラフィックス統合型 Intel H55 チップセット搭載

H55MXV-LE は、グラフィックス統合型 CPU をサポートする H55 チップセットを搭載した Micro ATX 規格、LGA1156、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Intel Core i7(8xx シリーズ対応)、Intel Core i5、Intel Core i3、Pentium G に対応します。グラフィックス統合型 CPU を使用することで、オンボードのグラフィックスを使用することができます。

・高い耐久性、アルミ固体コンデンサ採用

CPU 周りにアルミ固体コンデンサを採用しています。電解コンデンサに比べ経年劣化が少なく、さらに高い耐久性を実現しました。

・DDR3 デュアルチャンネル 1333MHz 対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 1333/1066/800MHz に対応します。

・PCI Express2.0 対応

接続バスには、従来の PCI Express1.1 に加え、2 倍の帯域幅を実現する新世代バス規格の PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェースの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速なデータ転送により快適なドライブ環境を提供します。

・最大データ転送速度 1000Mb/s ギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供いたします。高速な転送速度により、応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。優れたネットワークパフォーマンスを実現します。

・6 チャンネルオーディオ対応

最高品質のオーディオ再生性能を備え、High Definition Audio に対応しています。最大 6 チャンネルの音声を同時再生することができます。マルチストリーミング機能に対応し、手軽なセットアップが可能になりました。

・色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin 搭載

色分けされたフロントパネルコネクタ EasyPin を搭載しています。迷うことなくケーブルを取り付けられるので便利です。

・Windows 7 認証！

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 の環境で安心して使うことができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・EuP Lot6 サポートで待機電力 1W 以下を実現

EuP Lot 6 をサポートします。電源オフ時の待機電力を 1W 以下に抑えます。EuP (Directive on Eco-Design of Energy-using Products) 指令とは環境配慮設計に関する、欧州連合の新しい指令です。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboard/EuP/index.html>

【H55MXV-LE 製品詳細】

型番	H55MXV-LE	
CPU	対応ソケット	LGA1156
	対応 CPU	Intel Core i7 (8xx シリーズ対応) Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G
チップセット	Intel H55 Express	
メモリ	メモリスロット	2
	メモリ規格	DDR3 1333/1066/800MHz
	メモリ最大容量	8GB
	デュアルチャンネル対応	
オンボードグラフィックス	Intel H55 チップ	DVI-D D-Sub ※オンボードグラフィックスを使用するには、グラフィックス統合型 CPU (Core i5 6xx シリーズ、Core i3、Pentium G) を使用する必要があります。
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC662
	オーディオ規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111DL
拡張スロット	PCI Express x16	1 (x16 動作)、PCI Express 2.0 対応
	PCI Express x1	1
	PCI	2
SATA 3Gb/s	実効速度	3Gb/s
	Intel H55 チップ	6
USB 2.0/1.1	Intel H55 チップ	最大 10 (バックパネルコネクタ × 4、内部 I/O コ

		ネクタ×6)※最大数利用するには別途 USB ケーブルをご用意ください。
内部コネクタ	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントオーディオ接続	1
	フロントパネル接続	1
	スピーカー接続	1
	S/PDIF 出力	1
	USB 2.0/1.1	3
	SATA 3Gb/s	6
	TPM	1
	CIR	1
	INTR	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード	1
	PS/2 マウス	1
	USB 2.0/1.1	4
	DVI-D	1
	D-Sub	1
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	3
I/O コントローラ	チップ	iTE IT8721F
BIOS	AMI BIOS	64Mbit フラッシュ
		ACPI、WfM、DMI 2.0
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	Micro ATX
	サイズ	244 × 229mm
付属品	SATA ケーブル	2
	SATA 電源コネクタ→ペリフェラル電源変換ケーブル	2

【H55MXV-LE 発売詳細】

-型番

H55MXV-LE

-発売日

2010 年 6 月 26 日

-店頭予想売価

7,700 円前後 (OPEN)

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/foxconn-intel/h55mxvle.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=757>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

FOXCONN 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>